电感可靠性测试规范

(内部)

Prepared by 拟制	付世勇	Date 日期	2020年3月2日
Reviewed by	 朱晓明	Date	2020年3月15日
审核	木 妮奶	日期	2020年3月13日
Reviewed by		Date	
审核		日期	
Approved by		Date	
批准		日期	

贴片功率电感/插件电感/SMD电感

上述电感的可靠性测试分为环境测试和物理测试。环境测试主要测试电感的耐温性,耐湿性,热冲击等;物理测试主要是测试电感的强度,可焊性,再流焊,跌落,碰撞等。

1. 环境测试

IEC 68-2-1A 6.1 6.2 低温储存试验标准		
1、无明显的外观缺陷;	2、感值变化不超过10%;	
3、品质因数变化不超过30%;	4、直流电阻变化不超过10%;	
温度: -25±2℃	时间: 96±2hours样品在室温下放置1小	
	时,不超过2小时必须测试。	

MIL-STD-202G Method 103B 湿度测试标准		
1、无明显的外观缺陷;	2、感值变化不超过10%;	
3、品质因数变化不超过30%;	4、直流电阻变化不超过10%;	

- 1) 样品必须先在40±5℃条件下干燥24小时;
- 2) 干燥后测试;
- 3) 暴露: 温度: 40±2℃, 湿度: 93±3%RH, 时间: 96±2小时;
- 4) 暴露结束后,在试验箱中进行测试;
- 5) 样品在室温下放置1小时,不超过2小时必须测试。

MIL-STD-202G Method 107G 热冲击测试标准		
1、无明显的外观缺陷;	2、感值变化不超过10%;	
3、品质因数变化不超过30%;	4、直流电阻变化不超过10%;	
从-40℃作用T分钟,然后温度冲击到125℃作用T分钟,作为一个循环,共作用20次。		

2. 物理性测试

MIL-STD-202G Method 208H IPC-J-STD-002B 可焊性测试 solder coverage端子必须有95%以上着锡。

- 1、端子浸入助焊剂然后浸入245±5℃锡炉中5秒
- 2、焊料: Sn(63)/Pb(37)
- 3、助焊剂: 松香助焊剂

IPC J-STD-020B 过再流焊测试

- 1、无明显的外观缺陷
- 2、感值变化不超过10%
- 3、品质因数变化不超过30%
- 4、直流电阻变化不超过10%
- 1、参照下页回流焊曲线过三次
- 2、峰值温度为: 245±5℃

MIL-STD-202G Method 201A 振动测试标准		
1、无明显的外观缺陷;	2、感值变化不超过10%;	
3、品质因数变化不超过30%;	4、直流电阻变化不超过10%;	
用10-55Hz振动频率0.75mm振幅沿X,Y,Z方向各振动2小时(共6小时)		

MIL-STD-202G Method 203C 落下测试标准		
1、无明显的外观缺陷;	2、感值变化不超过10%;	
3、品质因数变化不超过30%;	4、直流电阻变化不超过10%;	
将产品包装后从1米高度自然落下至试验板上 1角1棱2面。		

JIS C 5321 : 1997 端子强度试验标准

定义: A: 焊接端子截面积 A≤8mm², 推力≥5N;

时间: 30秒 8mm²≤20mm² ,推力≥10N;

时间: 10秒20mm², 推力≥20N;

时间: 10秒; 弯折测试: 将产品焊于PCB上, 分别经过推力测试和弯折测试后端子不会发生松脱。将PCB对中弯折, 到达挠度2mm

IEC 68-2-45: 1993 耐溶剂性试验标准

无外观破坏及标记损坏在IPA溶剂中浸泡5±0.5分钟,室温下干燥5分钟,然后擦拭10次。



一体成型电感

一体电感的测试也分为环境测试和物理测试两种。环境测试主要测试电感的耐温性,耐湿性,热冲击等;物理测试主要是测试电感的强度,可焊性,再流焊,跌落,碰撞等。

1. 环境测试

高温储存试验:无明显的外观缺陷,感值变化不超过10%,品质因数变化不超过30%, 直流电阻变化不超过10%;温度:85±2℃;时间:样品在室温下放置1小时,不超过2小时必须 测试。

2. 物理性测试

- (1)可焊性测试:端子必须有95%以上着锡:端子浸入助焊剂然后浸入245±5℃锡炉中5秒,助焊剂使用松香助焊剂。
- (2)过再流焊测试:无明显的外观缺陷,感值变化不超过10%,品质因数变化不超过30%,直流电阻变化不超过10%。
- (3)振动测试:无明显的外观缺陷,感值变化不超过10%,品质因数变化不超过30%, 直流电阻变化不超过10%,用10-55Hz振动频率0.75mm振幅沿X、Y、Z方向各振动2小时(共6小时)。
- (4) 落下测试: 无明显的外观缺陷,感值变化不超过10%,品质因数变化不超过30%, 直流电阻变化不超过10%

3. 弯折测试

将一体成型电感焊于PCB上,分别经过推力测试和弯折测试后端子不会发生松脱,将PCB对中弯折,到达挠度2mm。

4. 一体成型电感耐溶剂性试验

一体成型电感在无外观破坏及标记损坏的情况下,在IPA溶剂中浸泡5±0.5分钟,室温下干燥5分钟,然后擦拭10次